

2019年11月18日

第3回接着・接合研究シンポジウムのご案内

拝啓

歳末ご多端の折 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

当コンソーシアムにおいて例年開催しております接着・接合研究シンポジウムに関しまして、本年度も下記の通り、第3回接着・接合研究シンポジウムを開催させて頂きます。

今回の海外招待講演者としまして、接着接合部の強度評価の第一人者である Imperial College London : Bamber Blackman 氏、非破壊検査の重鎮である Fraunhofer-Institute for Nondestructive Testing IZFP : Bernd Valeske 氏をお招きし、ご講演頂きます。また、国内招待講演者としまして、株式会社デンソー：青木 孝司 氏より、車載品等の接着技術に関してご講演頂きます。

年末のお忙しいところ、ご面倒をお掛け致しますが、奮ってご参加いただけましたら幸いです。

敬具

記

第3回接着・接合研究シンポジウム －接着の適用技術とその展開－

日時：令和元年12月2日（月）10:00～17:00

場所：ベルサール神田

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル2・3F

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/tokyo-bs_kanda/access/

プログラム：

10:00-10:05 開会の挨拶

10:05-11:05 招待講演1：Fracture mechanics characterisation of structural adhesive joints:

Achievements and future challenges

Dr B R K Blackman

Reader in the Mechanics of Materials, Department of Mechanical Engineering,
Imperial College London, United Kingdom

- 11:05-12:05 招待講演 2 : Cognitive Sensor Systems and Next Generation NDT:
New potentials and approaches for evaluation of smart materials data
- Application Scenarios for lightweight constructions and joints
Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske,
Vice Director of Fraunhofer IZFP and Head of Expert Group on
NDT4.0 (Digitalization of NDT) at the German Society for Nondestructive Testing (DGZfP)
- 12:05-12:30 海外招待講演者との意見交換
- 12:30-14:00 休憩
- 14:00-15:00 招待講演 3 : 自動車分野における接着接合技術の取り組み
株式会社デンソー 本社 材料技術部 次長 青木 孝司
- 15:00-15:30 接着・接合技術コンソーシアムのこれまでの活動概要と今後の展開
接着・接合技術コンソーシアム 副代表 田嶌 一樹
- 15:30-16:00 海外動向調査報告
産総研 製造技術研究部門 研究グループ長 寺崎 正
- 16:00-17:00 ポスターセッション